

<<中国集成电路产业发展论述文集>>

图书基本信息

书名：<<中国集成电路产业发展论述文集>>

13位ISBN编号：9787504209559

10位ISBN编号：7504209554

出版时间：2006-3

出版时间：新时代出版社

作者：朱贻玮

页数：402

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<中国集成电路产业发展论述文集>>

内容概要

本书集收录了作者自1989年以来所写的一批关于中国集成电路产业发展善的调研报告，以及有关中国集成电路产业发展道路和技术策略等方面的论述，共40篇文章，按内容分为七大部分，每部分中的文章按时间顺序编排。

作者在文中给出充实的数据、图表和明确的论点。

对于人们了解中国集成电路产业发展历程和指导、规划当前中国集成电路企业和产业的发展都会有一定的参考价值。

读者对象：从事或关心我国集成电路产业发展的有关部门、机构、企业的领导、抗美援朝人员以及高等院校师生。

作者简介

朱贻玮，1963年毕业于清华大学无线电系半导体专业。至退休前，三十多年始终工作在我国半导体和集成电路产业界。曾作在我国半导体和集成电路产业界。曾参与我国第一台第三代电子计算机所用集成电路的研究工作，参加我国第一个半导体集成电路专业化工厂——位于北京的国营东光电工厂的建设，并长期负责该厂技术领导工作。之后，参与北京燕东微电子联合公司4英寸芯片生产线引进的组织领导工作。多次参加国家五年计划集成电路行业规划工作，并在北京电子振兴领导小组办公室主管集成电路工作五年。获得教授级高级工程师职称。

1997年退休后继续为海峡两岸集成电路产业的合作贡献，并专注于我国集成电路产业的发展状况。

自1989年开始，十多年来在报刊杂志上发表了数十篇文章。

<<中国集成电路产业发展论述文集>>

书籍目录

第一部分 集成电路简介 第一篇 集成电路(IC)简介 第二篇 海峡两岸半导体有关术语对照表
第二部分 世界集成电路产业发展简史及状况 第一篇 微电子技术发展现状及趋势 第二篇 世界、中国、北京半导体和集成电路发展简史 第三篇 世界及中国硅圆片生产线统计图表第三部分 中国集成电路产业发展历史 第一篇 中国微电子转折的“九五” 第二篇 中国半导体产业发展的过去、现在和将来 第三篇 中国半导体产业发展的节奏 第四篇 中国集成电路产业发展四十年第四部分 中国集成电路产业发展状况 第一篇 中国IC芯片工艺线现状 第二篇 中国IC芯片生产线发展现状 第三篇 吹响建设北方微电子基地的号角 第四篇 北京地区微电子技术领域发展报告 第五篇 中国IC芯片制造工艺线状况及各地区发展前景 第六篇 中国长江三角洲地区IC芯片制造工艺线建设现状 第七篇 快速建设中的我国IC芯片制造线 第八篇 北京半导体产业综述 第九篇 “十五”计划过半时中国IC芯片制造工艺线建设现状 第十篇 半导体集成电路芯片产业现状及发展趋势 第十一篇 中国各地IC芯片线建设分布现状及其展望 第十二篇 中国集成电路产业全局发报告 第十三篇 中国集成电路产业发展现状与对存在的主要问题的思考 第十四篇 中纬(宁波)公司一厂建成投产 第十五篇 浙江省第一条6英寸硅圆片厂——中纬公司在宁波保税区建成投产 第十六篇 我国IC制造新的里程碑 第十七篇 中国IC芯片制造线建设现状及“十五”末预测第五部分 中国集成电路产业发展预测 第一篇 中国IC生产红(芯片加工厂)市场容量预测 第二篇 2010年中国集成电路产业前景第六部分 如何加速发展我国集成电路产业 第一篇 加速发展我国集成电路产业 第二篇 中国集成电路(IC)产业发展缓慢原因探讨 第三篇 加速发展中国微电子产业的策略建议 第四篇 浅论Foundry线与IC产品公司、设计单位的关系 第五篇 如何发展我国Foundry业务 第六篇 我国IC设计业 差距·对策 第七篇 如何加速发展我国IC制造业 第八篇 北京燕东微电子有限公司4英寸线不平凡的十五年历程 第九篇 浅论5英寸-6英寸硅片加工市场 第十篇 浅谈半导体二手设备第七部分 集成电路产业投资问题 第一篇 论集成电路芯片制造线的投资问题 第二篇 论集成电路芯片制造线的投资问题(演示文稿) 附录A 英文简写词中文译名 附录B 中国半导体及集成电路研制单位简称与全称对照表

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>